

本体高さ1.2mmの小型タイプで
片側はね返りストローク2mmを実現。



■主な仕様

項目		仕様
最大定格／最小定格(抵抗負荷)		10mA 5V DC/50 μ A 3V DC
接触抵抗(初期／寿命後)		10 Ω max./10 Ω max.
作動力		1 $\pm$ 0.5N
動作寿命	無負荷	100,000cycles
	負荷	100,000cycles(10mA 5V DC)

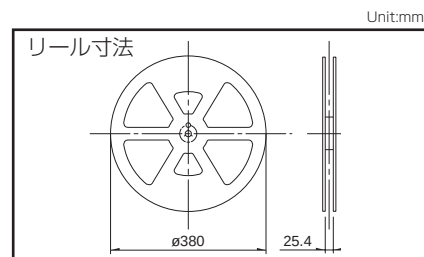


■製品一覧

移動量 (mm)	操作部方 向	回路数	接点数	切換 タイミング	はんだ付 方法	動作	枠足形状	位置 決めピン	最小発注単位 (pcs.)		製品番号	図番
									国内	輸出		
2	Horizontal	1	2	Not specified	Reflow	左側はね返り	フラット	なし	6,000	24,000	SSAL120100	1
						右側はね返り					SSAL220100	2
						左側はね返り	基板挿入		4,500	18,000	SSAL120201	3
						右側はね返り					SSAL220200	4

■梱包仕様
テーピング

製品番号	梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1 リール	1 箱/国内	1 箱/輸梱		
SSAL120100 SSAL220100	6,000	12,000	24,000	24	428×413×172
SSAL120201 SSAL220200	4,500	9,000	18,000		



■外形図

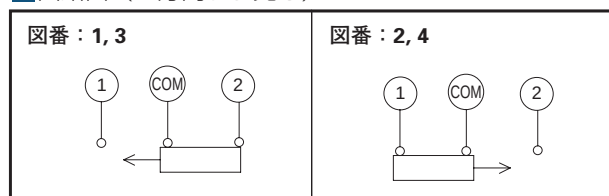
No.	形状	リフロー用パターン推奨寸法図
1		

■外形図

Unit:mm

No.	形状	リフロー用パターン推奨寸法図
2		
3		
4		

■回路図 (A 方向より見る)



スライドスイッチ

バラエティー一覧

検出

スライド

プッシュ

ロータリ

電源

ディップタイプ

小型汎用

大型汎用

シリーズ		SSAJ	SSSS8	SSAL	SSAG	SSSS7
写真						
操作部方向	Horizontal	●	●	●	●	●
	Vertical	—	●	—	—	—
回路接点数	1-2	●	●	●	—	●
	1-3	—	●	—	●	●
	1-4	—	—	—	—	—
	2-2	—	●	—	—	—
	2-3	—	●	—	—	—
	2-4	—	—	—	—	—
	4-2	—	—	—	—	—
移動量 (mm)		1.4	1.5, 2	2	1.5	2
使用温度範囲		−10℃ ~ +60℃	−40℃ ~ +85℃	−10℃ ~ +60℃		−40℃ ~ +85℃
車載対応製品		—	—	—	—	—
ライフサイクル						
最大定格 (抵抗負荷)		10mA 5V DC	0.3A 5V DC	10mA 5V DC		0.3A 4V DC
最小定格 (抵抗負荷)		50μA 3V DC				
耐久性	無負荷寿命	10,000cycles 500mΩ max.	10,000cycles 100mΩ max.	100,000cycles 10Ω max.	30,000cycles (ロック側) 100,000cycles (はね返り側) 500mΩ max.	10,000cycles 100mΩ max.
	負荷寿命 最大定格負荷にて		10,000cycles 130mΩ max.			10,000cycles 130mΩ max.
電気的 性能	初期接触抵抗	300mΩ max.	70mΩ max.	10Ω max.	200mΩ max.	70mΩ max.
	絶縁抵抗	100MΩ min. 100V DC				100MΩ min. 500V DC
	耐電圧	100V AC for 1minute				500V AC for 1minute
機械的 性能	端子強度		3N for 1minute			
	操作部 強度	作動方向	10N			
		引張方向				
耐候性	耐寒性	−40℃ 96h	−40℃ 500h	−40℃ 96h		−20℃ 500h
	耐熱性	85℃ 96h	85℃ 500h	85℃ 96h		85℃ 500h
	耐湿性	40℃, 90~95%RH 96h	60℃, 90~95%RH 500h	40℃, 90~95%RH 96h		60℃, 90~95%RH 500h
ページ		72	74	77	79	82

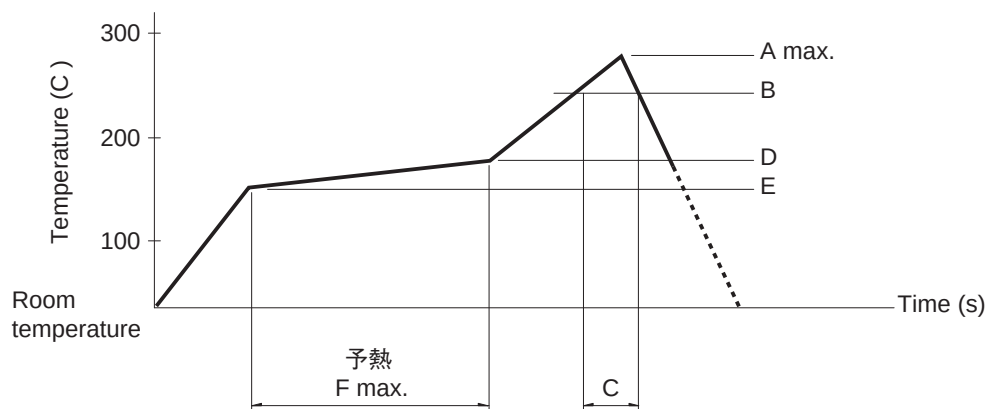
スライドスイッチはんだ付条件 106
スライドスイッチご使用上の注意 107

注記

表中の●印は、シリーズ中の全ての製品が対応していることを表します。

リフロー方式の参考例

- 加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
- 温度測定方式 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ の CA (K) または CC (T) を用い測定。位置ははんだ接合部（銅箔面）で測定。固定方式は耐熱テープを使用する。
- 温度プロファイル



シリーズ (リフロータイプ)			A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)
SSSS2	Vertical	1-pole, 3-position	260	230	40	180	150	120
	Horizontal	1-pole, 2-position 1-pole, 3-position 2-pole, 3-position						
	Vertical	1-pole, 2-position	250					
SSAG, SSAJ, SSAL, SSSS8, SSSS7			260					

注記

- 上記条件は、プリント基板の部品実装面上の温度です。基板の材質、大きさ、厚さなどにより基板温度とスイッチ表面温度が大きく異なる場合がありますので、スイッチ表面温度についても上記条件内でご使用ください。
- リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

手はんだ方式の参考例

シリーズ	はんだ温度	はんだ付け時間
SSSF, SSSU	350±10°C	3+1/0s
SSSS2	350±10°C	4s max.
SSSS9	350±10°C	3s max.
SSAG, SSAJ, SSAL	350±5°C	3s max.
SSSS8	330±5°C	3s max.
SSSS7	320±5°C	3s max.
SSAC	300±10°C	2s max.

ディップ方式の参考例

For PC board 端子タイプに適用

シリーズ	項目		ディップはんだ	
	プリヒート温度	プリヒート時間	はんだ温度	はんだ浸漬時間
SSSS2	100°C max.	60s max.	260±5°C	3±1s
SSSS9	120°C max.	60s max.	260±5°C	5+0/-1s(2回)
SSSF, SSSU	100°C max.	60s max.	260±5°C	10±1s/5±1s
SSAC	100°C max.	60s max.	260±5°C	5±1s